

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2022-013

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于分公司重大项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（以下简称“亚翔新加坡分公司”）于近日收到United Microelectronics Corporation (Singapore Branch)（联华电子股份有限公司新加坡分公司）发来的订单（编号：2409826-12I1ADF），确认亚翔新加坡分公司成为联华电子「新加坡12吋晶圆厂第三厂/第四厂扩建统包工程」之先期基桩工程的承包单位。现将相关情况公告如下：

### 一、业主信息

联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）为全球半导体晶圆专工业界的领导者，提供高质量的晶圆制造服务，专注于逻辑及特殊技术，为跨越电子行业的各项主要应用产品生产芯片。联电完整的制程技术及制造解决方案包括逻辑/混合信号、嵌入式高压解决方案、嵌入式非挥发性内存、RFSOI 及 BCD。

## 二、中标项目概况

- 1、项目名称：联华电子「新加坡12吋晶圆厂第三厂/第四厂扩建统包工程」之先期基桩工程
- 2、项目地址：3 PASIR RIS DRIVE 12, SINGAPORE 519528
- 3、招标单位：United Microelectronics Corporation (Singapore Branch)（联华电子股份有限公司新加坡分公司）
- 4、建设单位：United Microelectronics Corporation (Singapore Branch)（联华电子股份有限公司新加坡分公司）
- 5、中标金额：72,406,900新加坡元（大写：柒仟贰佰肆拾万陆仟玖佰新加坡元）（含税）
- 6、工程期限：整体建厂计划完工期限为2023年12月
- 7、工程概况：厂区内主要建物包含FAB栋、CUB栋、PSB栋、WWT栋、OB栋、LAB栋及Gas Yard等各栋建物之基桩工程及其相关假设工程工作。

## 三、本项目执行对公司的影响

本项目的顺利实施将有助于提高公司在海外的业务承接能力，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。

## 四、风险提示

公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注

意投资风险。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年4月21日